




UcamX v2021.04



Release Überblick

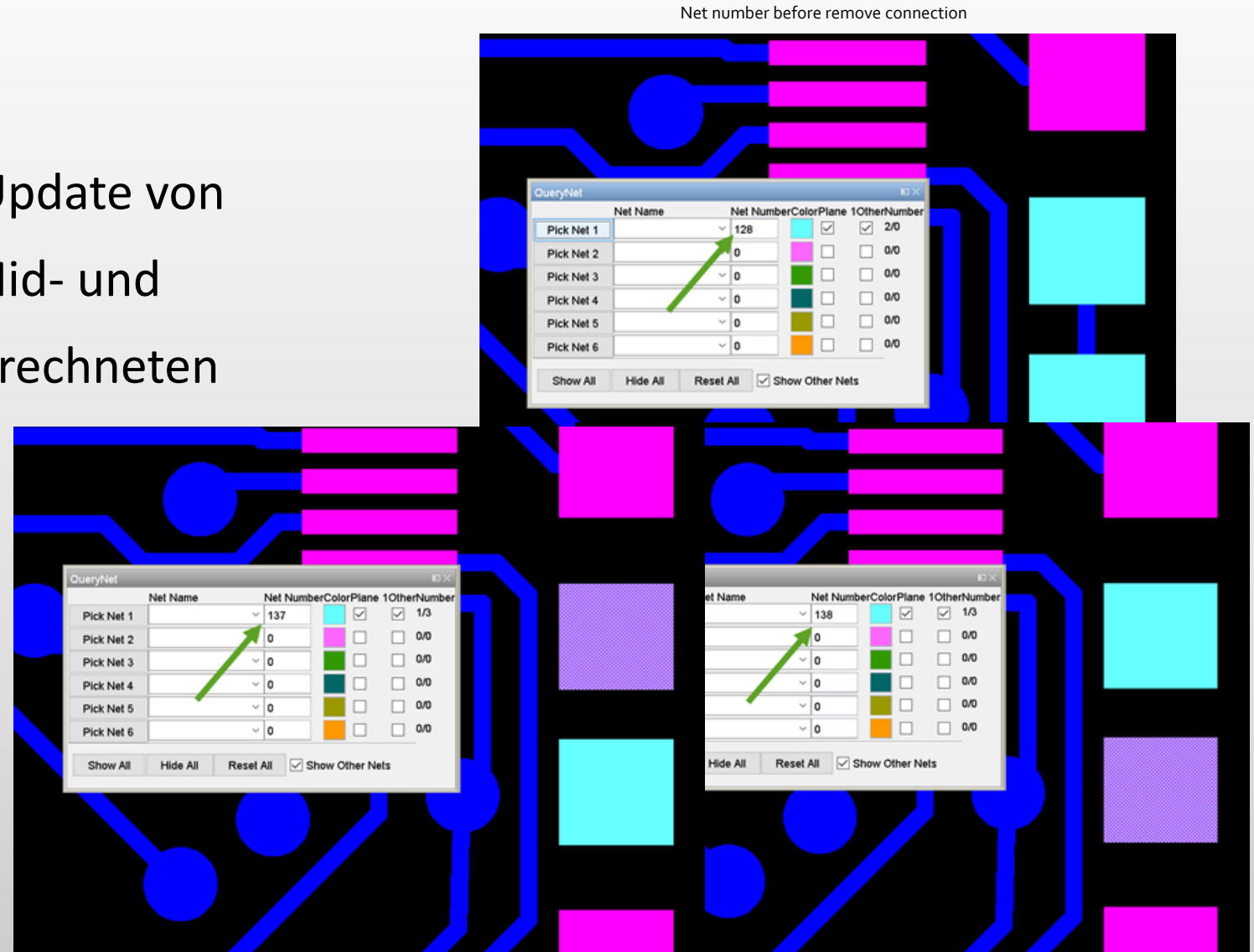
Immer einen Schritt voraus...

- Netlist Erweiterung 
- YELO Copper Adjuster Erweiterungen
- YELO Legend Adjuster Erweiterungen
- YELO Mask Adjuster (Beta) Erweiterungen
- Reduzierte Datenmenge im SEC
- Neue Ledia Ausgabe 
- Optimierte ODB++ Ausgabe 
- Und mehr!

Erweiterung

- **Ressourcenschonendes** Update von Netznummern in Test-, Mid- und Probe-Lagen, den neu berechneten Netzlisteninformationen entsprechend

(Ergänzung zur existierenden Netlist Lizenz)



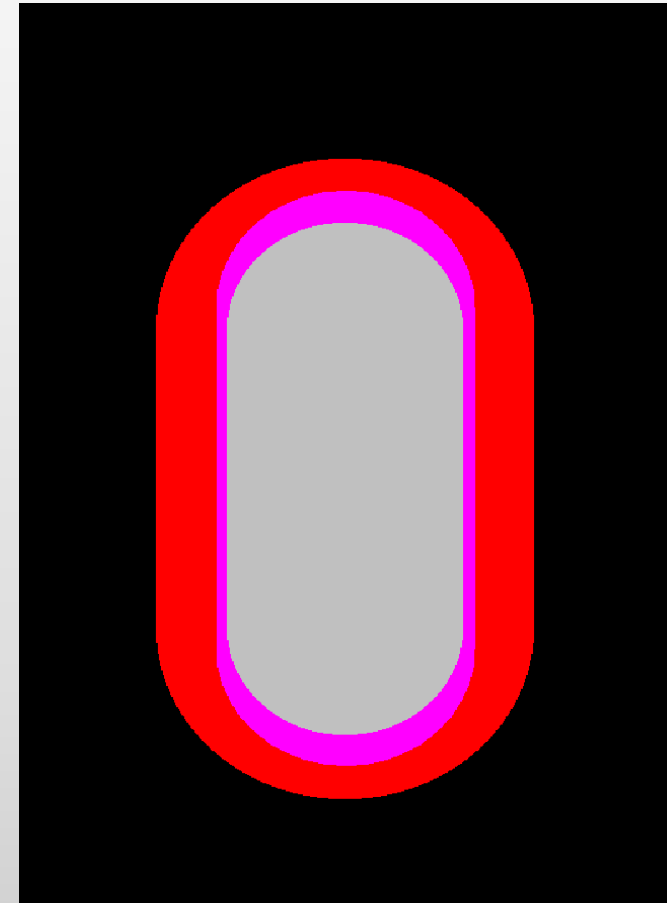
Different net numbers on test layers by only running netlist again

Erweiterungen

- Restringfehler an **durchkontaktierten Schlitten** werden gemeldet und repariert
- Mechanisch erzeugte Via Bohrungen können vergrößert werden um die **minimale Bohrungsgröße** zu erfüllen
- Stegentfernungen an Kupferflächen sind so optimiert dass **unnötige Pads entfallen**

(Ergänzung zum existierenden Copper Adjuster)

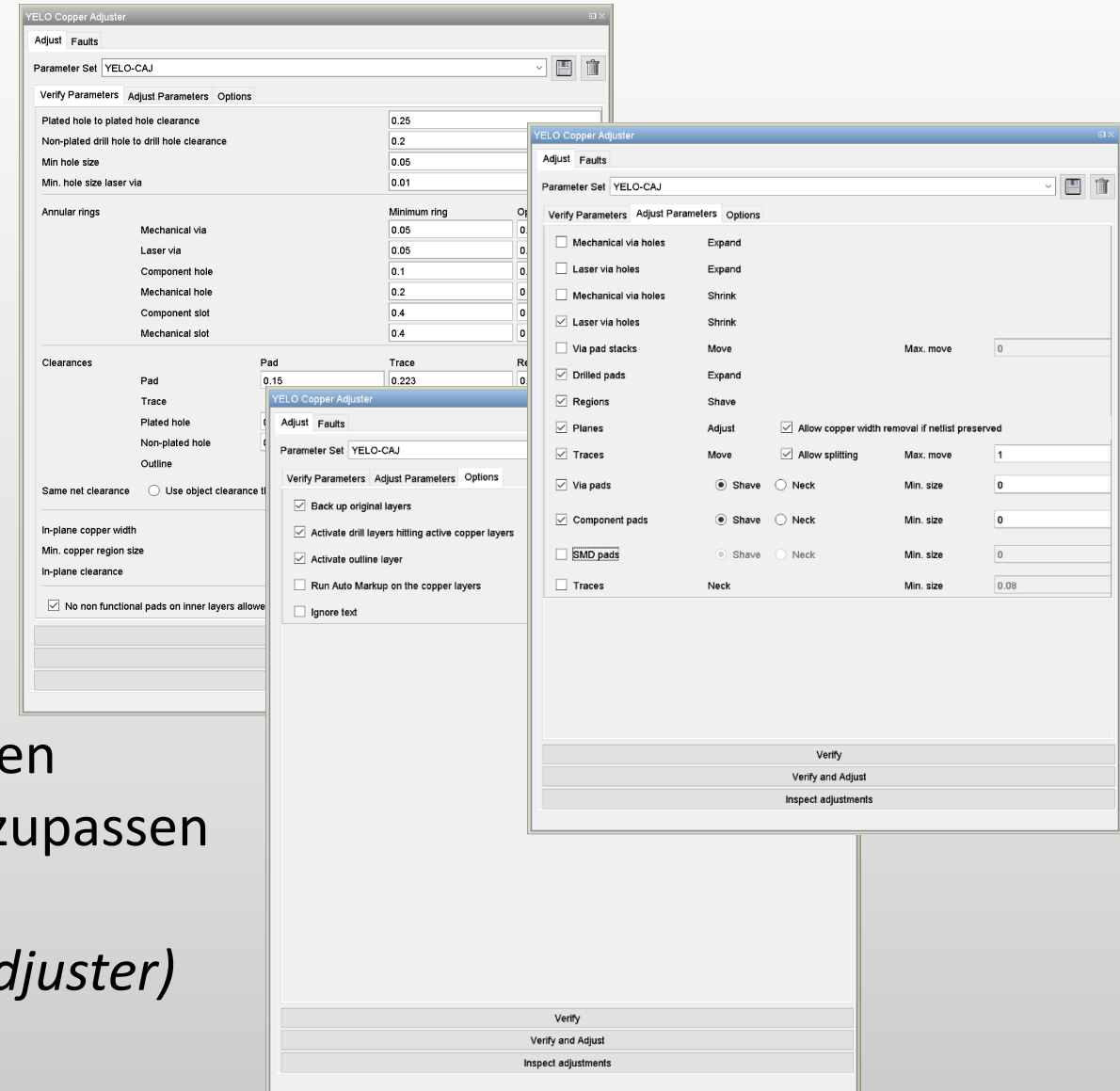
Ring faults for plated slots are reported and repaired



Erweiterungen

- Eine **neue Option** um Text auszuschließen. Alle elektrischen Netze ohne Pads gelten als Text
- **Verbesserte GUI** mit Reitern für ein besseres Handling
- Aktualisierte Restring-Parameter. 4 neue Parameter um **Schlitze** auf einen zugeordneten Restring-Parameter anzupassen

(Ergänzung zum existierenden Copper Adjuster)

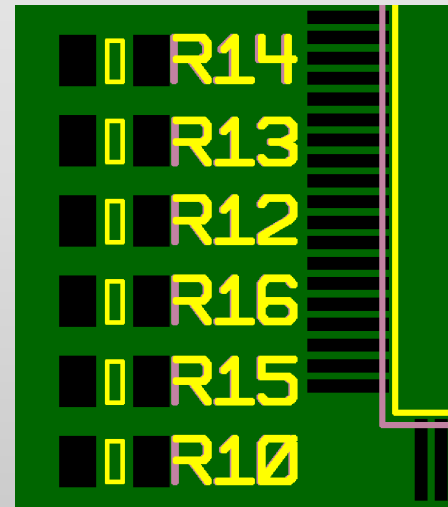


Erweiterung

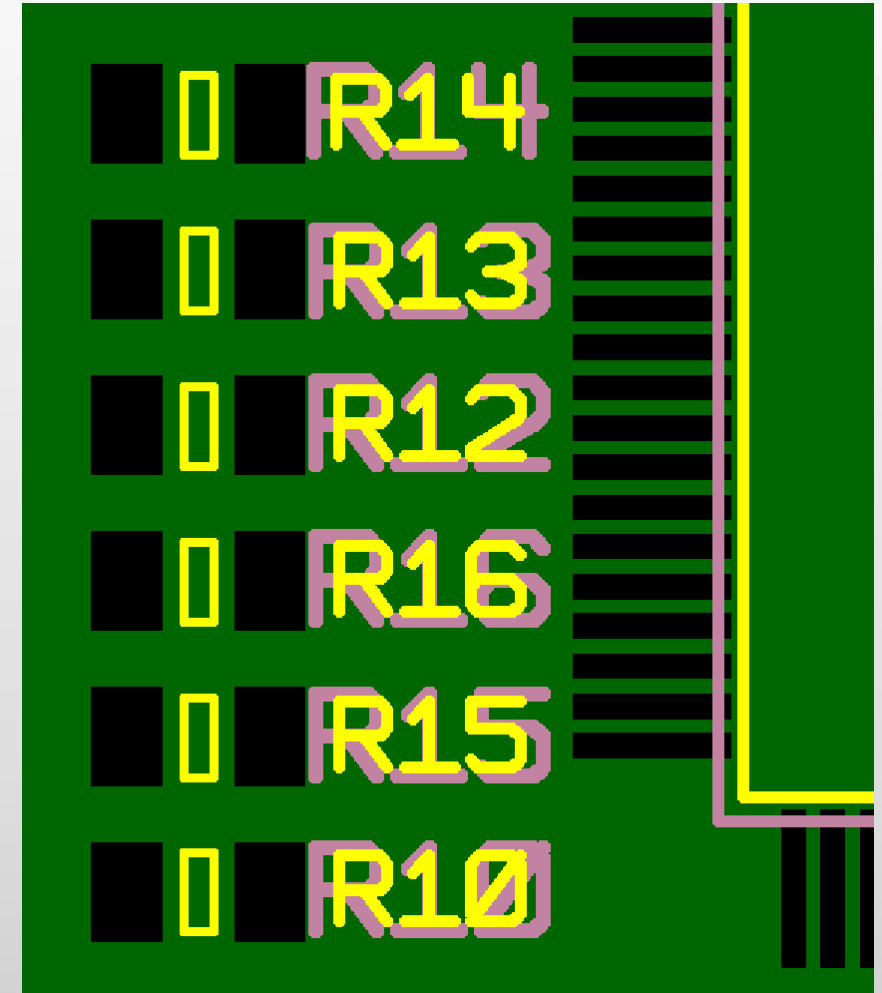
- Der “Adjust” Reiter beinhaltet eine neue Option um **alle Texte in einem Durchgang**, mit einem spezifizierten Faktor, zu skalieren
Die minimale Linienbreite wird dabei immer respektiert.

(Ergänzung zum existierenden Legend Adjuster)

Not enough space to move the text -> text will be shaved



No shave necessary after scaling text



Reduzierung der Datenmenge

- **Beschleunigen** Sie die Dateiverarbeitung mit der neuen Option, die Anzahl der Objekte für Abstandskorrekturen zu reduzieren, indem zusammenhängende Objekte zusammengefasst werden.
- Die SEC GUI wurde um eine neue Option «Finalize» und ein Kontrollkästchen «Auto Finalize» erweitert, um **negative Objekte** zu **beseitigen**.
«Finalize», muss manuell angestoßen werden. Es erstellt eine Netzliste und wendet „Expand True Objects“ auf allen aktiven Lagen an
«Auto Finalize» wird **automatisch** am Ende von «Apply» ausgeführt, um negative Objekte zu beseitigen

(Ergänzung zur existierenden SEC Lizenz)

*Änderung der Dateigröße
(gleiche Daten – gleiche
Werte)*

Vor den Neuerungen:

11.182 MB

Mit 'Finalize':

7.235 MB

*Mit Zusammenfassen
zusammenhängender
Objekte:*

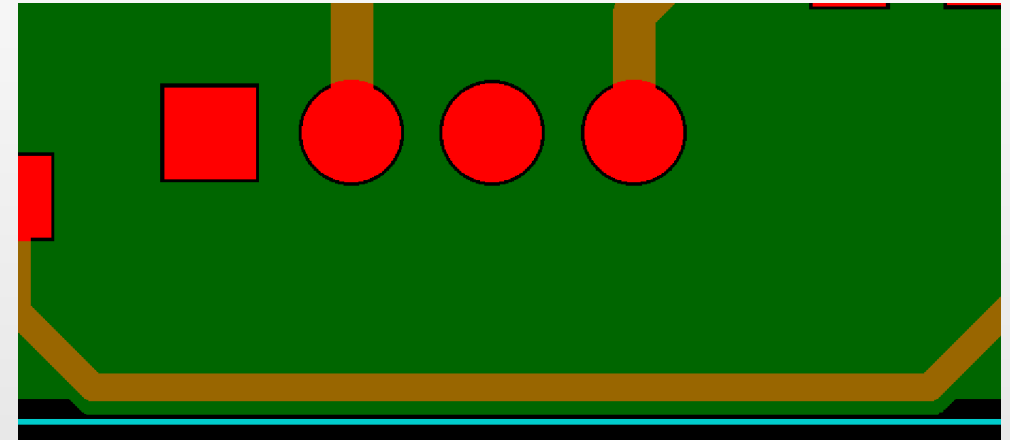
1.616 MB

Erweiterungen

- Aufgrund der positiven Resonanz in der ersten Testphase wird die Testversion für diese Version **verlängert**
- **Neue** Option zum Entfernen vorhandener Via-Maskenöffnungen
- Freistellung der Maske zur Outline und Überhang **implementiert**

(Verfügbar für Maintenance-Kunden mit bestehender "Soldermask Optimizer" Lizenz)

Removing soldermask from outline while ensuring mask overhang
Example: traces



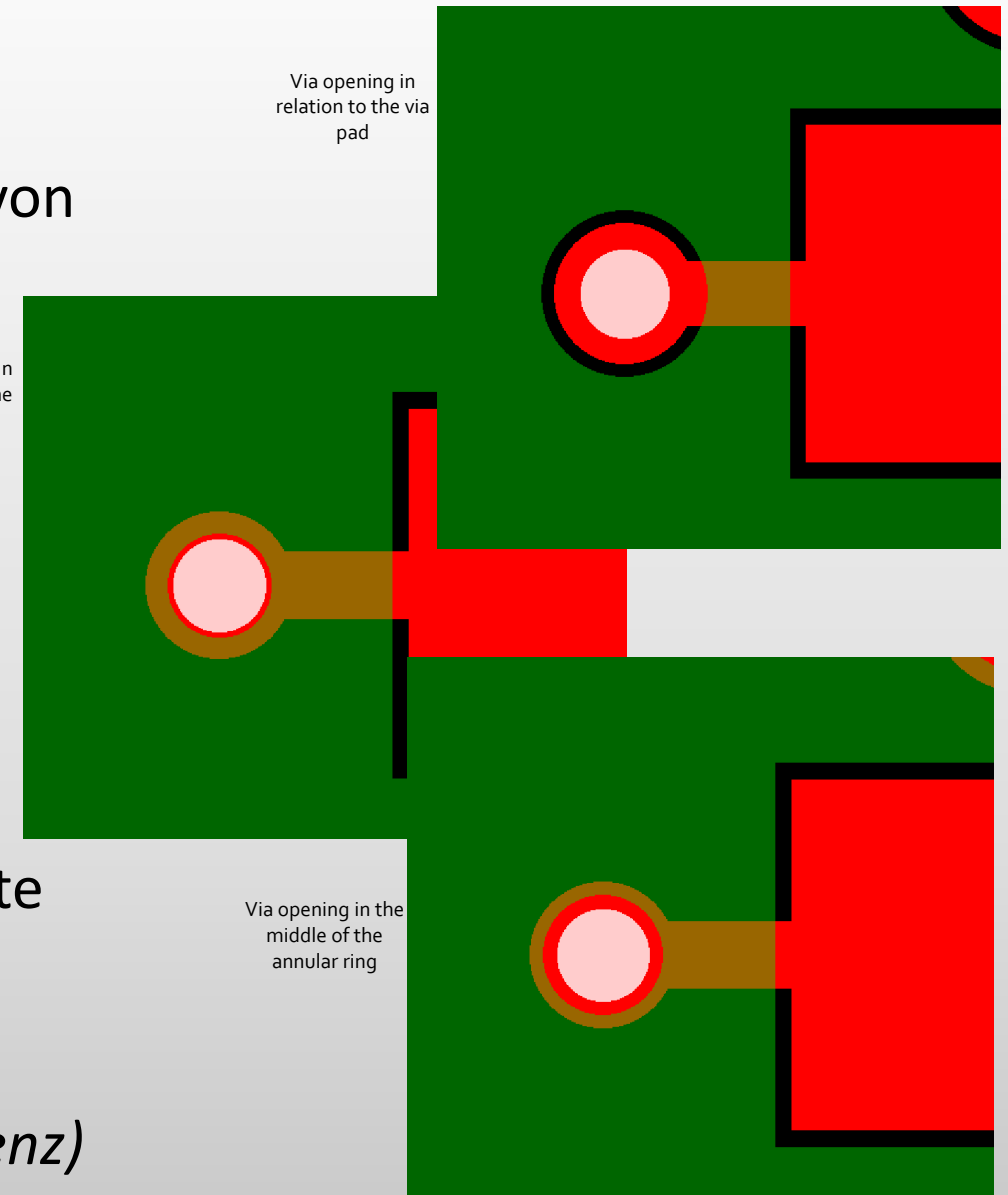
Example: region



Erweiterungen

- **Erweiterte** Funktionalität für die Anpassung von Via Öffnungen auf exakt die Mitte zwischen Bohrungswand und Kupferpad
- Handling von Ausschnitten und Innenausfräsungen **implementiert**
- Ringe für nicht plattierte Slots wurden dem Mask Adjuster hinzugefügt. Es behandelt diese auf die gleiche Weise wie nicht plattierte Bohrungen

(Verfügbar für Maintenance-Kunden mit bestehender "Soldermask Optimizer" Lizenz)



Neue Hotfolder Lösung

- Daten zur Belichtung an die Ledia-Maschine senden, ohne sich um die Softwareversion CU9000 zu kümmern
- UcamX ist völlig **unabhängig** von CU9000, es sendet keine Daten direkt zum Ledia RIP sondern sendet die Daten zum CU9000 Hotfolder

(Neue Option, kostenfrei verfügbar für Maintenance-Kunden mit bestehender "Dainippon Screen DI Output" Lizenz)



The screenshot shows the 'SCREEN LI Output' dialog box with the following settings:

- Group: DI Testdata
- Job: Top
- Front Layer: Bot
- Front Layer Name: Bot
- Back Layer: Bot
- Back Layer Name: Bot
- Machine: ledia (LediaS_365_385_405)
- Board Setup File: C:\SS\DS_DI_ROOT\brd\221181.brd
- Resist Setup File: (empty)

Board Setup section:

- Board Setup: Load ... Save ...
- Size: 458 615
- Thickness: 0.15
- Mirror: None
- Rotation: 0
- Polarity: Positive
- Alignment Center: Job Layer CAD
- Offset: -0.5 1.5
- Alignment Points: 3 Marks Detect
- Image File: hole_2mm

AP	X	Y
AP1	454.498	259.499
AP2	2.498	114.499
AP3	2.498	495.499
AP4	0	0

Alignment options: CAD Board Machine

Hide Global Alignment

Back Layer Mirror: Y

Conversion Mag. 1.0003 times 1.00045 times

Plot Mag. 1.0 times 1.0 times

Group Scaling: Max Min

Scaling Tol. X: 0.0 % 0.0 %

Scaling Tol. Y: 0.0 % 0.0 %

Hide Output Options

Apply to front layers

Apply to back layers

Keep layer order

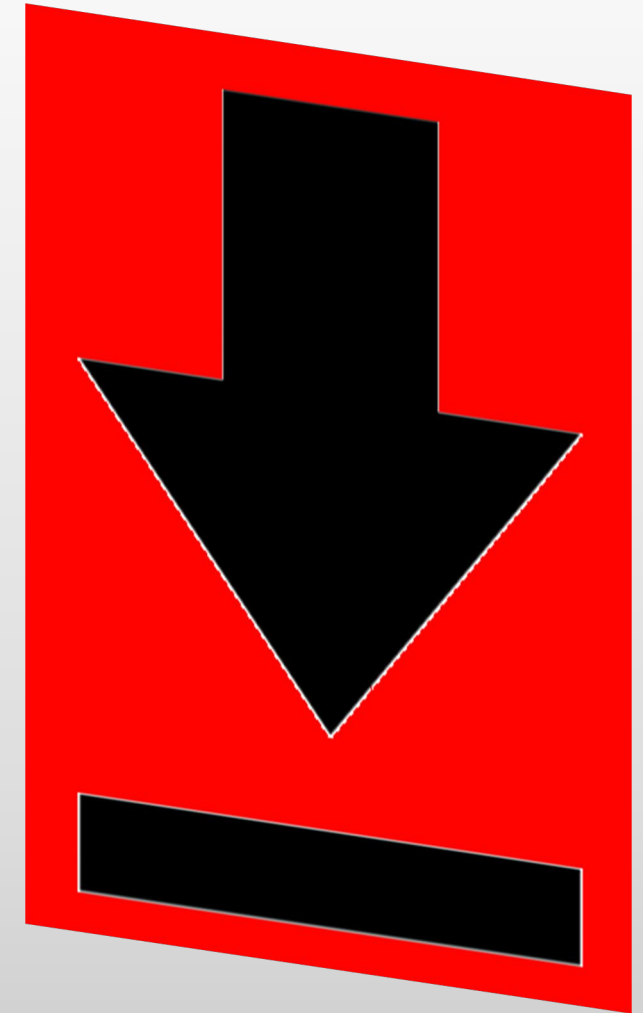
Buttons: Preview Apply XML Output

Optimierung

- Die ODB++ Ausgabe berücksichtigt den Skalierungsfaktor, der einer Blockblendedefinition zugewiesen ist.
Dieser Skalierungsfaktor wurde bisher bei der ODB++ Ausgabe ignoriert.

(Ergänzung zur existierenden "CAD Output ODB++" Lizenz)

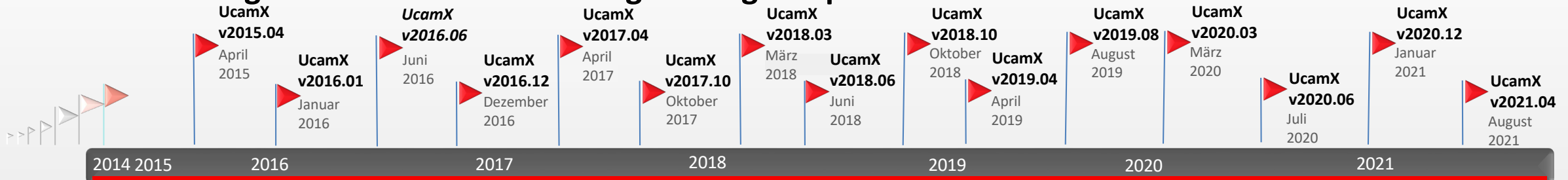
- Das Installationsprogramm kann vom Ucamco FTP-Downloadserver heruntergeladen werden. Da die meisten Internetbrowser den FTP-Download nicht mehr unterstützen, empfehlen wir die Verwendung eines FTP-Clients
- Wir empfehlen, dieses Update so bald wie möglich zu installieren
- Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren lokalen Geschäftspartner oder an den Ucamco-Helpdesk
- Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Ucamco-Produkt entschieden haben



Schon jetzt nach vorne schauen



Wir versorgen unsere Kunden mit regelmäßigen Updates



Version	Release Datum	Highlights	Today
2021.04	Jun-21	Reduzierung der SEC Daten, Erweiterung aller YELO Module, optimierte Netliste, Neuer Ledia Output für Java 8 und Java 11	
2020.12	Jan-21	DPMX Import, Text Updater, Linienbreiten Anpassung in YELO Legend Adjuster, Via Pad Stack Move in YELO Copper Adjuster	
2020.06	Jul-20	Prüfung der eindeutigen Kombination aus Subclass, Attach und Index Nummer	
2020.03	Mar-20	Upgraded auf Java 11, Neuer Select Painted Algorithmus, Neue YELO Funktionen, Gerber X3 Input (Bauteilinformationen)	
2019.08	Aug-19	Keyboard Shortcuts, Plane Focus Indikator, Maintenance update	
2019.04	Apr-19	YELO Kombinierte GUI für alle Kupferlagen, YELO Erweiterungen bestehender Funktionalitäten, Rout Manager Verbesserungen	
2018.10	Nov-18	Query Component, Einlesen der Bauteilinformationen aus ODB++	
2018.06	Jun-18	Speichern von Jobs in Archiven, zeitlich begrenzter Test aller YELO Module	
2018.03	Mar-18	Eagle Input mit proportionalem Font, Skalierte Linienbreite in Silk optimizer, Vorstellung von YELO Signal Adjuster	
2017.10	Oct-17	Neue Startroutine für UcamX, Erweiterter "Job Editor View", optimierte Fräskompensation	
2017.04	Apr-17	Gesteigerte Leistungsfähigkeit, verbesserte "Same Net Spacing" und "Select Painted" Algorithmen	
2016.12	Dec-16	Neue "Insert Arc" Option, verbesserter Import von Excellon Fräsprogrammen	
2016.06	Jun-16	Erhaltungsrelease	
2016.01	Jan-16	CAD-Output im Hintergrund (Backgrounding), "Paralleles Image Compare"	
2015.04	Apr-15	Load balanced sessions, Gerber X2 Input support	

© Copyright 2021 Ucamco NV, Gent, Belgium. All rights reserved.

This material, information and instructions for use contained herein are the property of Ucamco NV. The material, information and instructions are provided on an AS IS basis without warranty of any kind.

Ucamco NV does not warrant, guarantee or make any representations regarding the use, or the results of the use of the software or the information contained herein.

Ucamco NV shall not be liable for any direct, indirect, consequential or incidental damages arising out of the use or inability to use the software or the information contained herein.

The information contained herein is subject to change without prior notice.

Revisions may be issued from time to time to advise of such changes and/or additions.

No part of this presentation may be reproduced, stored in a data base or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior written permission from Ucamco NV.